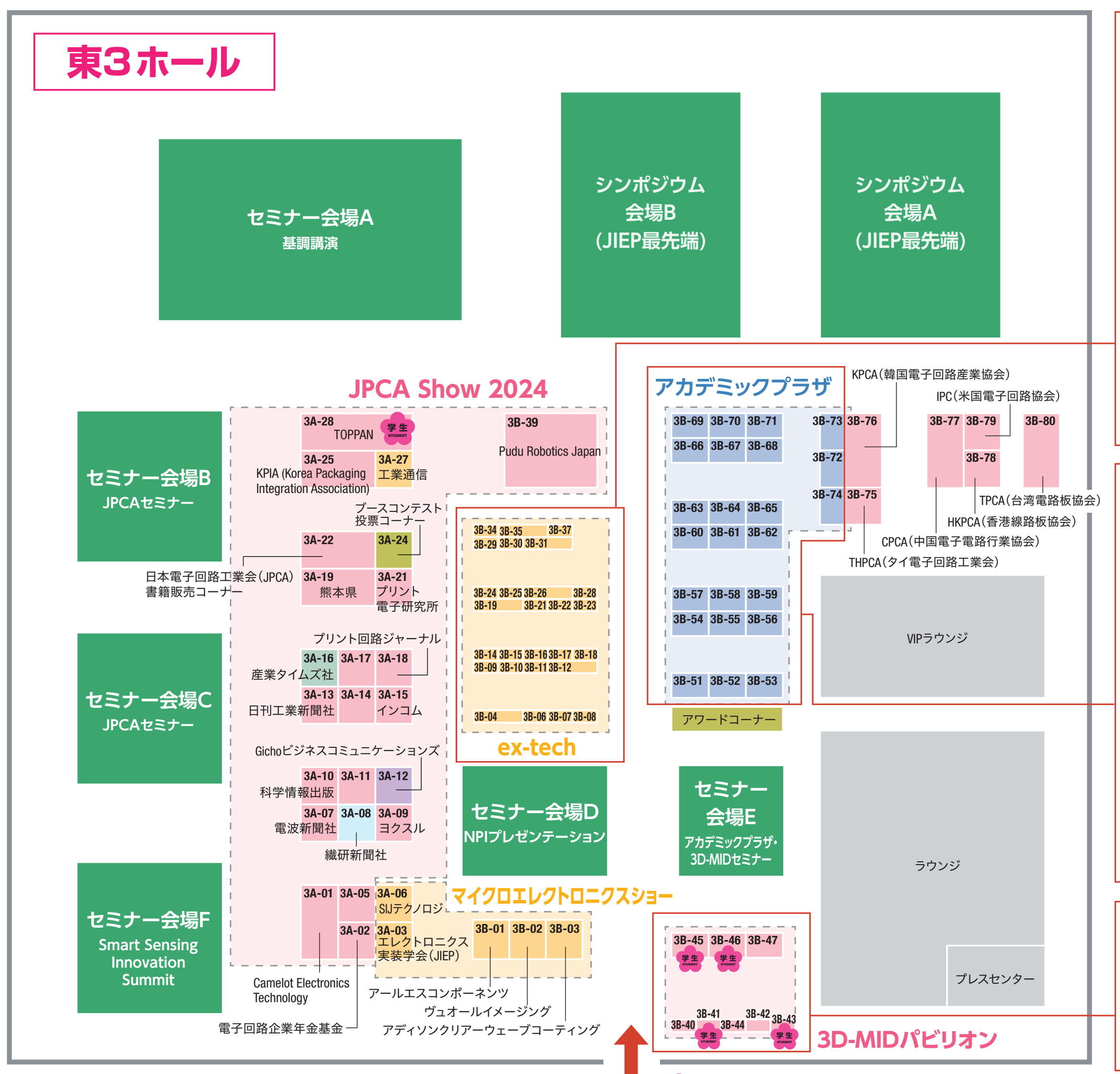
会場案内図

JPCA Show 2024 第53回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第38回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2024 第25回 実装プロセステクノロジー展 / METAVERSE DEVICE EXPO メタバースデバイス展 / WIRE Japan Show 2024 ～装置と装置をつなぐ～ 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 / E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング



eX-tech

3B-04	電気印刷研究所
3B-06	奥野製薬工業
3B-07	ハニー化成
3B-08	カネカテクノリサーチ
3B-09	アテネ
3B-11	トープロテクノサービス
3B-12	イープロニクス
3B-14	星光PMC
3B-15	太洋工作所
3B-16	JNC石油化学 / JNC
3B-17	TEGソリューション
3B-18	電子技研
3B-19	エスペック
3B-21	日邦産業
3B-22	長瀬産業
3B-23	秋田化学工業
3B-24	三ツ星ベルト
3B-25	Shimada Appli
3B-26	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン
3B-28	大阪有機化学工業
3B-29	プラズマイオンアシスト
3B-30	大阪公立大学/大阪産業技術研究所
3B-31	ノードソン
3B-34	東芝ビジネスエキスパート
3B-35	アンドールシステムサポート

アカデミックプラザ

3B-51	国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室
3B-52	信州大学
3B-53	徳島大学
3B-54	山形大学
3B-55	山形県工業技術センター
3B-56	愛媛大学大学院理工学研究科
3B-57	東京工芸大学
3B-58	日本大学 内木場・金子研究室
3B-59	日本大学理工学部精密機械工学科
3B-60	東京理科大学
3B-61	東京理科大学
3B-62	公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構
3B-63	群馬大学
3B-64	群馬大学大学院 理工学府
3B-65	北海道大学
3B-66	関東学院大学
3B-67	関東学院大学大学院工学研究科
3B-68	神奈川県立産業技術総合研究所
3B-69	九州大学
3B-70	崇城大学
3B-71	東北大学
3B-72	横浜国立大学
3B-73	横浜国立大学
3B-74	山陽小野田市立山口東京理科大学

3D-MIDパビリオン

3B-40	日本MID協会
3B-41	ワンダーフューチャーコーポレーション
3B-42	岩手県工業技術センター
3B-43	三共化成
3B-44	アルティウム ジャパン
3B-45	図研
3B-46	EBINAX
3B-47	太陽インキ製造

第20回 JPCA賞

この度、JPCA賞（アワード）選考委員会にて、厳正なる審査の上、第20回JPCA賞（アワード）受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA賞（アワード）は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性（独自性・オリジナリティ）』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、学術界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々で構成するJPCA賞（アワード）選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

【表彰式】セミナー会場C　日時：6/12（水）16:40～16:55

JPCA賞　（社名50音順）

- ■高速通信基板向け熱硬化性低誘電樹脂の開発　JSR　小間番号 5F-48
- ■パワー半導体向け高放熱絶縁材料　太陽インキ製造　小間番号 5F-47
- ■JTAG検査とフライングプローブテスタを組み合わせたハイブリッド検査システム　タカヤ／アンドールシステムサポート　小間番号 4C-38
- ■次世代低反りBTレジン積層板材料　HL832RS/GHPL-830RS　三菱ガス化学　小間番号 5F-38

JPCA奨励賞

- ■高密度貫通スルーホールコア基板向け電解銅めっき液　上村工業　小間番号 5F-12
- ■パワーデバイス向けリードフレーム用　粒状銅めっき添加剤 トップクラスターAR　奥野製薬工業　小間番号 6H-08
- ■低誘電正接を特長とする真球状非晶質シリカ　Sciqas®-LTシリーズ　堺化学工業　小間番号 5F-36
- ■IHリフロー技術による電子基板製造の社会的課題の解決（SDGs・PFAS規制対応）　ワンダーフューチャーコーポレーション　小間番号 3B-41

半導体・オブ・ザ・イヤー2024

半導体オブ・ザ・イヤー 2024は、2023年4月～2024年3月の間に発表された新製品・新技術の中から産業タイムズ社にて厳正に選出いたしました。

【表彰式】セミナー会場G　日時：6/12（水）14:00～17:00（受付開始13：30～）

主催者 産業タイムズ社

【半導体デバイス部門】		
グランプリ	NVIDIA	NVIDIA Blackwell プラットフォーム
優秀賞	Power Diamond Systems	ダイヤモンド半導体における世界最高ドレイン電流を実現したMOSFETの開発
優秀賞	東北大学	STT-MRAM素子の極限微細化技術
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	TOWA	生成AI向け半導体の生産に最適なモールディング装置「YPM1250-EPQ」
優秀賞	レーザーテック	アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A300」シリーズ
優秀賞	横浜国立大学、ディスコ、東レエンジニアリング	新たなチップ集積手法によるDie-to-Wafer ハイブリッド接合技術の開発
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	旭化成、Crystal IS	4インチ窒化アルミニウム（AIN）単結晶基板
優秀賞	DIC	環境配慮型の高性能PFASフリー界面活性剤「MEGAFACE EFSシリーズ」を開発
優秀賞	TOPPAN	次世代半導体向けコアレス有機インターポーザー

2024アカデミックプラザ受賞者

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会委員会（越地委員長：東京工芸大学 工学部 総合工学系 電気電子コース、大学院 工学研究科 電子情報工学専攻、基礎教育研究センター 教授）で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定いたしました。

【表彰式】セミナー会場E　日時：6/12（水）16:40～17:00

- ■ハイブリッド接合における接合強度と界面評価　横浜国立大学
- ■圧搾ガス駆動による内視鏡接続型MEMSマイクロロボットの開発　日本大学／マイクロデザイン研究室
- ■電子機器の温度上昇を抑制する超小型MEMS ペーパーチャンバーの開発　日本大学／マイクロデザイン研究室
- ■待機状態IC の入力配線検査を行うバウンダリスキャン用コントローラの試作　徳島大学大学院創成科学研究科　徳島大学大学院社会産業理工学研究部　放送大学徳島学習センター
- ■ITO 透明導電膜を利用したコプレーナ線路の伝送特性の検討　東京工芸大学 工学部

来場者参加型企画

ブースコンテスト　【投票コーナー：3A-24】

皆様、ブース投票にご参加下さい!!

【投票期間】6月12日（水）・6月13日（木）

ブースコンテストを今年も開催！

【ナイスデザイン賞】・【ベスト展示賞】・【特別賞】が皆様の投票で決定します。投票していただいた皆様へは粗品を進呈いたします。

学生向けオリエンテーション&ツアー

（各日先着20名）　**留学生の方も大歓迎！**

10:30～11:15 オリエンテーション

11:15～12:00 展示会ツアー

事前に学生窓口（東5ホール前）での受付をお済ませください。

また、「学生ウェルカムブース」を公式ホームページに掲載していますのでご覧ください。　Check

学生 STUDENT

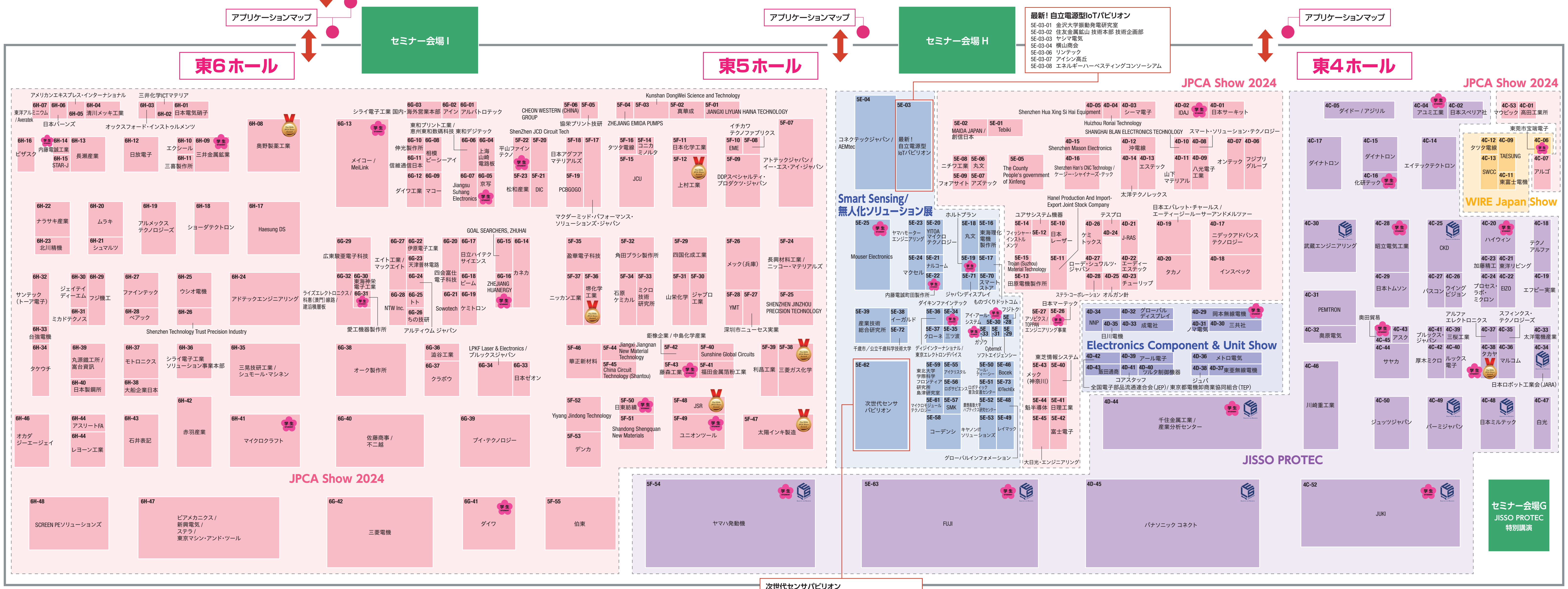
アプリケーションマップ

業界が注目するアプリケーション分野を分類し、それぞれに関連する製品や技術を保有する出展者をマップで会場入口に示しており、展示会公式サイトでも掲載しています。

関心のある分野の出展者をマップで容易に検索し、視察をスムーズに行うことができます。ぜひご活用ください。

自動運転　EV　パワー半導体／ガラス基板　アドバンスドパッケージ　気候変動対策

アプリケーション・マップへの参加企業は公式ホームページにも掲載しています！　Check



最新！自立電源型IoTパビリオン

5E-03-01	金沢大学振動発電研究室
5E-03-02	住友金属鉱山 技術本部 技術企画部
5E-03-03	ヤシマ電気
5E-03-04	横山商会
5E-03-06	リンテック
5E-03-07	アイシン高丘
5E-03-08	エネルギーハーベスティングコンソーシアム

次世代センサパビリオン

5E-62-1	MODE, Inc.	5E-62-9	南陽
5E-62-2	ソラコム	5E-62-10	マルティスープ
5E-62-3	アルプスアルパイン	5E-62-11	デルタツーリング
5E-62-4	藤倉コンポジット	5E-62-12	SUPWAT
5E-62-5	TOPPAN	5E-62-13	i-PRO
5E-62-6	マクニカ	5E-62-14	泰興物産
5E-62-7	FCLコンポーネント	5E-62-15	AWL
5E-62-8	インタープロ	5E-62-16	日東電工

凡例　JPCA賞・JPCA奨励賞 受賞出展者　学生ウェルカムブース　ELS支持企業・団体

MacDermid Alpha ELECTRONICS SOLUTIONS　5F-17
MEIKO　6G-13
ADTEC ENGINEERING　6H-24
Dynatron　4C-15 4C-17
太陽インキ製造　5F-47 3B-47
MEC　5F-26
V-TECHNOLOGY　6G-39
mks | ESI　5F-07
mks | Atotech　5F-07
KYOSHA　6G-05
SHOWA エレクトロニクスで貢献する　5F-23
KB 建滔積層板控股有限公司 KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED　6G-32
nikkan　5F-37
TOA MUSENDENKI Electronics & DX solutions　4D-37
JPCA めっき委員会

出展者リスト

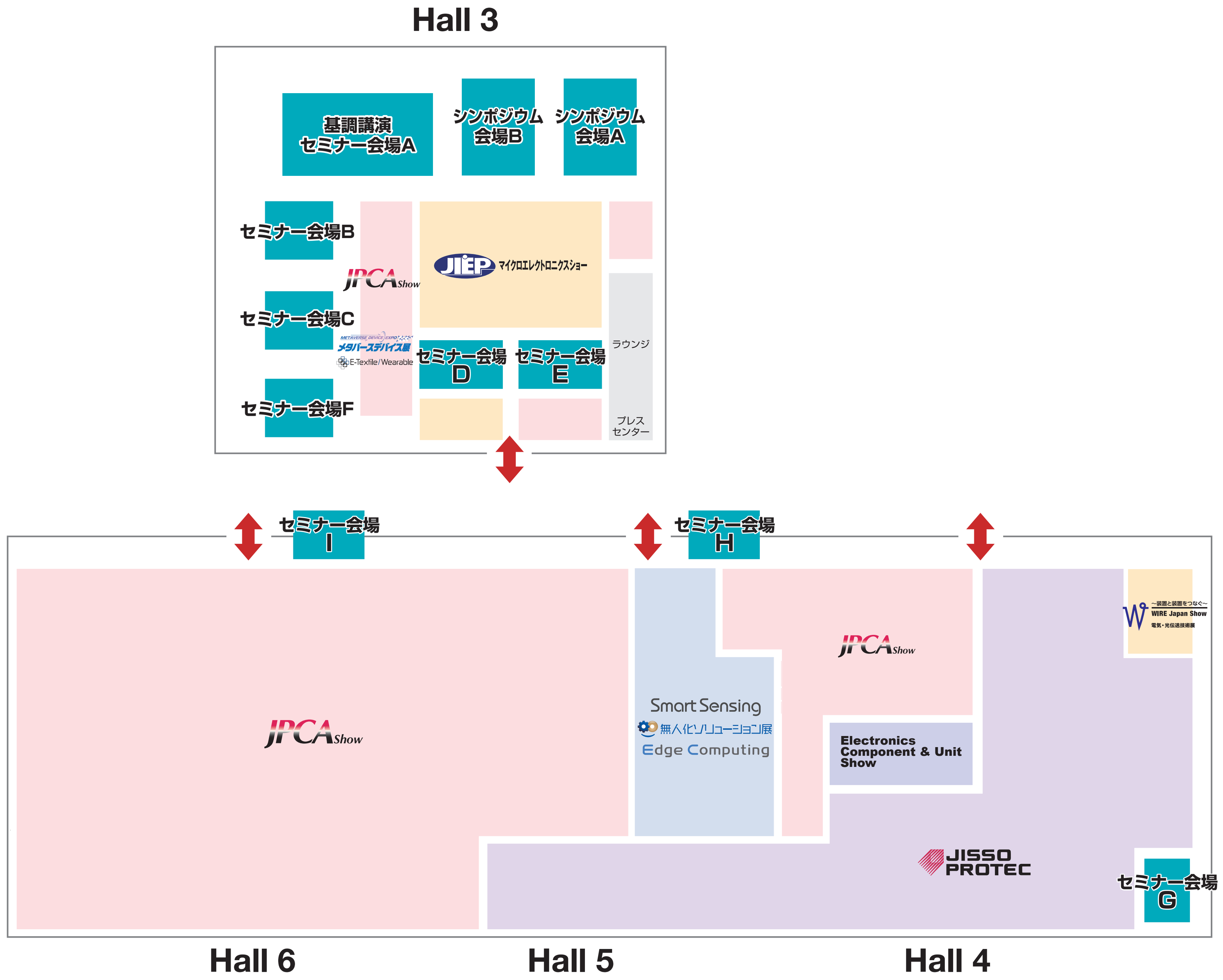
JPCA Show 2024 第53回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第38回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2024 第25回 実装プロセステクノロジー展 / METAVERSE DEVICE EXPO メタバースデバイス展 / WIRE Japan Show 2024 ～装置と装置をつなぐ～ 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 / E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング

	会社名	小間番号	展示会名
あ	アールエスコンポーネンツ	3B-01	マイクロエレクトロニクスショー
	アール・ティー・シー	5E-50	Smart Sensing
	アール電子	4D-39	Electronics Component & Unit Show
	アイ・アール・システム	5E-30	Smart Sensing
	アイクリスタル	5E-55	Smart Sensing
	愛工機器製作所	6G-31	プリント配線板技術展
	アイシン高丘	5E-03-07	Smart Sensing
	IDAJ	4D-02	プリント配線板技術展
	IDTechEx	5E-73	Smart Sensing
	IPC（米国電子回路協会）	3B-79	プリント配線板技術展
	i-PRO	5E-62-13	Smart Sensing
	アイン	6G-02	プリント配線板技術展
	AWL	5E-62-15	Smart Sensing
	赤羽産業	6H-42	プリント配線板技術展
	秋田化学工業	3B-23	eX-tech
	アジリル	4C-05	JISSO PROTEC
	アスク	4C-43	JISSO PROTEC
	アズテック	5E-07	【ゾーン】アドバンスドパッケージング技術
	アスリートFA	6H-44	プリント配線板技術展
	アソビクス	5E-27	機器・半導体受託生産システム展
	厚木ミクロ	4C-42	JISSO PROTEC
	アディソンクリアーウェーブコーティング	3B-03	マイクロエレクトロニクスショー
	アテネ	3B-09	eX-tech
	アドテックエンジニアリング	6H-24	プリント配線板技術展
	アトテックジャパン	5F-07	プリント配線板技術展
	Averatek	6H-07	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	アメリカンエキスプレス・インターナショナル	6H-05	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	アユミ工業	4C-04	JISSO PROTEC
	アルゴ	4C-07	プリント配線板技術展
	アルティウム ジャパン	6G-24	プリント配線板技術展
	アルティウム ジャパン	3B-44	3D-MIDパビリオン
	アルパトロテック	6G-01	プリント配線板技術展
	アルファエレクトロニクス	4C-37	JISSO PROTEC
	アルプスアルパイン	5E-62-3	Smart Sensing
	アルメックステクノロジーズ	6H-19	プリント配線板技術展
	アンドールシステムサポート	3B-35	eX-tech
い	イー・エス・アイ・ジャパン	5F-07	プリント配線板技術展
	EME	5F-10	プリント配線板技術展
	イーガルド	5E-38	Smart Sensing
	飯田通商	4D-43	Electronics Component & Unit Show
	イープロニクス	3B-12	eX-tech
	Yiyang Jindong Technology	5F-52	プリント配線板技術展
	石井表記	6H-43	プリント配線板技術展
	石原ケミカル	5F-34	プリント配線板技術展
	イチカワテクノファブリクス	5F-08	プリント配線板技術展
	YITOAマイクロテクノロジー	5E-20	Smart Sensing
	伊原電子工業	6G-22	プリント配線板技術展
	岩手県工業技術センター	3B-42	3D-MIDパビリオン
	インコム	3A-15	機器・半導体受託生産システム展
	インスペック	4D-18	プリント配線板技術展
	インタープロ	5E-62-8	Smart Sensing
	盈華電子科技	5F-35	プリント配線板技術展
う	ウイングビジョン	4C-26	JISSO PROTEC
	上村工業	5F-12	プリント配線板技術展
	ウシオ電機	6H-25	プリント配線板技術展
	ヴュオールイメージング	3B-02	マイクロエレクトロニクスショー
え	EIZO	4C-22	JISSO PROTEC
	HKPCA（香港線路板協会）	3B-78	プリント配線板技術展
	エイテックテクトロン	4C-14	JISSO PROTEC
	エイト工業	6G-27	プリント配線板技術展
	AEMtec	5E-04	Smart Sensing
	エーディーエステック	4D-22	プリント配線板技術展
	エーティージールーサーアンドメルツァー	4D-19	プリント配線板技術展
	エクシール	6H-10	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	SIJテクノロジ	3A-06	マイクロエレクトロニクスショー
	SMK	5E-57	Smart Sensing
	SWCC	4C-13	WIRE Japan Show
	エステック	4D-13	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	エスペック	3B-19	eX-tech
	NNP	4D-34	Electronics Component & Unit Show
	NTW Inc.	6G-28	プリント配線板技術展
	エネルギーハーベスティングコンソーシアム	5E-03-08	Smart Sensing
	EBINAX	3B-46	3D-MIDパビリオン
	愛媛大学大学院理工学研究科	3B-56	アカデミックプラザ
	FCLコンポーネント	5E-62-7	Smart Sensing
	エフピー実業	4C-19	JISSO PROTEC
	LPKF Laser & Electronics	6G-34	プリント配線板技術展
	エレクトロニクス実装学会（JIEP）	3A-03	マイクロエレクトロニクスショー
お	オーク製作所	6G-38	プリント配線板技術展
	大阪公立大学／大阪産業技術研究所	3B-30	eX-tech
	大阪有機化学工業	3B-28	eX-tech
	大船企業日本	6H-38	プリント配線板技術展
	鉅橡企業	5F-42	プリント配線板技術展
	オカダジーエージェイ	6H-46	プリント配線板技術展
	岡本無線電機	4D-29	Electronics Component & Unit Show
	沖電線	4D-12	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	奥田貿易	4C-45	JISSO PROTEC
	奥野製薬工業	6H-08	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	奥野製薬工業	3B-06	eX-tech
	奥原電気	4C-32	JISSO PROTEC
	オックスフォード・インストゥルメンツ	6H-03	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	オルガン針	4D-25	プリント配線板技術展
	オンテック	4D-07	プリント配線板技術展
か	科学情報出版	3A-10	プリント配線板技術展
	化研テック	4C-16	JISSO PROTEC
	華正新材料	5F-46	プリント配線板技術展
	ガゾウ	5E-33	Smart Sensing
	加藤精工	4C-23	JISSO PROTEC
	神奈川県立産業技術総合研究所	3B-68	アカデミックプラザ
	金沢大学振動発電研究室	5E-03-01	Smart Sensing
	カネカ	6G-14	プリント配線板技術展
	カネカテクノリサーチ	3B-08	eX-tech
	川崎重工業	4C-46	JISSO PROTEC
	関東学院大学	3B-66	アカデミックプラザ
	関東学院大学大学院工学研究科	3B-67	アカデミックプラザ
	広東駿亜電子科技	6G-29	プリント配線板技術展
き	北川精機	6H-23	プリント配線板技術展
	Gichoビジネスコミュニケーションズ	3A-12	JISSO PROTEC
	キヤノンITソリューションズ	5E-53	無人化ソリューション展
	Camelot Electronics Technology	3A-01	プリント配線板技術展
	九州大学	3B-69	アカデミックプラザ
	協栄プリント技研	5F-05	プリント配線板技術展
	京写	6G-05	プリント配線板技術展
	清川メッキ工業	6H-04	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	建滔積層板	6G-32	プリント配線板技術展
く	熊本県	3A-19	プリント配線板技術展
	クラボウ	6G-37	プリント配線板技術展
	クローネ	5E-37	Smart Sensing
	グローバルインフォメーション	5E-48	Smart Sensing
	グローバルディスプレイ	4D-32	Electronics Component & Unit Show
	Kunshan DongWei Science and Technology	5F-03	プリント配線板技術展
	群馬大学	3B-63	アカデミックプラザ
	群馬大学大学院 理工学府	3B-64	アカデミックプラザ
け	慶應義塾大学ハプティクス研究センター	5E-52	無人化ソリューション展
	ケージー・シャイナーズ・テック	4D-16	プリント配線板技術展
	KPIA (Korea Packaging Integration Association)	3A-25	プリント配線板技術展
	KPCA（韓国電子回路産業協会）	3B-76	プリント配線板技術展
	ケミトックス	4D-26	プリント配線板技術展
	ケミトロン	6G-19	プリント配線板技術展
こ	コアスタッフ	4D-41	Electronics Component & Unit Show
	工業通信	3A-27	WIRE Japan Show
	公立諏訪東京理科大学　地域連携研究開発機構	3B-62	アカデミックプラザ
	コーデンシ	5E-58	Smart Sensing
	GOAL SEARCHERS, ZHUHAI	6G-15	プリント配線板技術展
	コニカミノルタ	5F-14	プリント配線板技術展
	コネクテックジャパン	5E-04	Smart Sensing
さ	CyberneX	5E-31	Smart Sensing
	堺化学工業	5F-36	プリント配線板技術展
	The County People's government of Xinfeng	5E-05	プリント配線板技術展
	相模ピーシーアイ	6G-08	プリント配線板技術展
	魁半導体	5E-44	機器・半導体受託生産システム展
	佐藤商事	6G-40	プリント配線板技術展
	サヤカ	4C-44	JISSO PROTEC
	山栄化学	5F-31	プリント配線板技術展
	三桜工業	4C-39	JISSO PROTEC
	三喜製作所	6H-11	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	三共化成	3B-43	3D-MIDパビリオン
	産業技術総合研究所センシングシステム研究センター	5E-39	Smart Sensing
	産業技術総合研究所人間拡張研究センター	5E-39	Smart Sensing
	三共社	4D-30	Electronics Component & Unit Show
	産業タイムズ社	3A-16	メタバースデバイス展
	産業分析センター	4D-44	JISSO PROTEC
	三晃技研工業	6H-35	プリント配線板技術展
	Sunshine Global Circuits	5F-40	プリント配線板技術展
	サンテック（トーア電子）	6H-32	プリント配線板技術展
	山陽小野田市立山口東京理科大学	3B-74	アカデミックプラザ
し	CKD	4C-25	JISSO PROTEC
	CPCA（中国電子電路行業協会）	3B-77	プリント配線板技術展
	シーマ電子	4D-03	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	JSR	5F-48	プリント配線板技術展
	JNC	3B-16	eX-tech
	JNC石油化学	3B-16	eX-tech
	ジェイテイディーエム	6H-30	プリント配線板技術展
	J-RAS	4D-21	プリント配線板技術展
	JCU	5F-15	プリント配線板技術展
	ShenZhen JCD Circuit Tech	5F-20	プリント配線板技術展
	SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	5F-25	プリント配線板技術展
	Shenzhen Technology Trust Precision Industry	6H-26	プリント配線板技術展
	Shenzhen Han's CNC Technology	4D-16	プリント配線板技術展
	四会富仕電子科技	6G-20	プリント配線板技術展
	四国化成工業	5F-29	プリント配線板技術展
	澁谷工業	6G-36	プリント配線板技術展
	Shimada Appli	3B-25	eX-tech
	Shenzhen Hua Xing Si Hai Equipment	4D-05	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	Shenzhen Mason Electronics	4D-15	プリント配線板技術展
	ジャパンディスプレイ	5E-71	Smart Sensing
	ジャブロ工業	5F-30	プリント配線板技術展
	Jiangxi Jiangnan New Material Technology	5F-44	プリント配線板技術展
	JIANGXI LIYUAN HAINA TECHNOLOGY	5F-01	プリント配線板技術展
	Jiangsu Suhang Electronics	6G-07	プリント配線板技術展
	Shandong Shengquan New Materials	5F-51	プリント配線板技術展
	SHANGHAI BLAN ELECTRONICS TECHNOLOGY	4D-10	プリント配線板技術展
	上海山崎電路板	6G-04	プリント配線板技術展
	JUKI	4C-52	JISSO PROTEC
	ジュッツジャパン	4C-50	JISSO PROTEC
	ジュパ	4D-38	Electronics Component & Unit Show
	シュマルツ	6H-21	プリント配線板技術展
	シュモール・マシネン	6H-35	プリント配線板技術展
	昭立電気工業	4C-28	JISSO PROTEC
	松和産業	5F-23	プリント配線板技術展
	ショーダテクトロン	6H-18	プリント配線板技術展
	シライ電子工業 国内・海外営業本部	6G-03	プリント配線板技術展
	シライ電子工業 ソリューション事業本部	6H-36	プリント配線板技術展
	信維通信日本	6G-11	プリント配線板技術展
	真華成	5F-02	プリント配線板技術展
	伸光製作所	6G-10	プリント配線板技術展
	新興電気	6H-47	プリント配線板技術展
	信州大学	3B-52	アカデミックプラザ
	深圳市ニューセス実業	5F-27	プリント配線板技術展
す	SCREEN PEソリューションズ	6H-48	プリント配線板技術展
	図研	3B-45	3D-MIDパビリオン
	STAR-J	6H-15	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	ステラ	6H-47	プリント配線板技術展
	ステラ・コーポレーション	4D-28	プリント配線板技術展
	スフィンクス・テクノロジーズ	4C-35	JISSO PROTEC
	SUPWAT	5E-62-12	Smart Sensing
	スマート・ソリューション・テクノロジー	4D-08	プリント配線板技術展
	スマートストア	5E-70	Smart Sensing
	住友金属鉱山 技術本部 技術企画部	5E-03-02	Smart Sensing
せ	星光PMC	3B-14	eX-tech
	成電社	4D-33	Electronics Component & Unit Show
	繊研新聞社	3A-08	イーテキスタイル／ウェアラブル展
	全国電子部品流通連合会（JEP）	4D-42	Electronics Component & Unit Show
	千住金属工業	4D-44	JISSO PROTEC
そ	崇城大学	3B-70	アカデミックプラザ
	Sowotech	6G-21	プリント配線板技術展
	ソフトエイジェンシー	5E-29	Smart Sensing
	ソラコム	5E-62-2	Smart Sensing
	嵩台資訊	6H-39	プリント配線板技術展
た	台強電機	6H-33	プリント配線板技術展
	ダイキンファインテック	5E-34	Smart Sensing
	泰興物産	5E-62-14	Smart Sensing
	ダイドー	4C-05	JISSO PROTEC
	ダイナトロン	4C-15 / 4C-17	JISSO PROTEC
	大日光・エンジニアリング	5E-45	機器・半導体受託生産システム展
	太陽インキ製造	5F-47	プリント配線板技術展
	太陽インキ製造	3B-47	3D-MIDパビリオン
	太洋工作所	3B-15	eX-tech
	太洋テクノレックス	4D-14	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	太洋電機産業	4C-33	JISSO PROTEC
	ダイワ	6G-41	プリント配線板技術展
	ダイワ工業	6G-12	プリント配線板技術展
	高田工業所	4C-01	プリント配線板技術展
	タカノ	4D-20	プリント配線板技術展
	タカヤ	4C-38	JISSO PROTEC
	タケウチ	6H-34	プリント配線板技術展
	タツタ電線	4C-12	WIRE Japan Show
	タツタ電線	5F-16	プリント配線板技術展
	田原電機製作所	5E-13	機器・半導体受託生産システム展
ち	CHEON WESTERN (CHINA) GROUP	5F-06	プリント配線板技術展
	千歳市／公立大学法人　公立千歳科学技術大学	5E-72	Smart Sensing
	ちの技研	6G-26	プリント配線板技術展
	China Circuit Technology (Shantou)	5F-45	プリント配線板技術展
	チューリップ	4D-23	プリント配線板技術展
	長興材料工業	5F-24	プリント配線板技術展
	ZHEJIANG EMIDA PUMPS	5F-04	プリント配線板技術展
	ZHEJIANG HUANERGY	6G-16	プリント配線板技術展
つ	角田ブラシ製作所	5F-32	プリント配線板技術展
	ツルタ制御機器	4D-40	Electronics Component & Unit Show
て	DIC	5F-21	プリント配線板技術展
	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン	3B-26	eX-tech
	THPCA（タイ電子回路工業会）	3B-75	プリント配線板技術展
	TPCA（台湾電路板協会）	3B-80	プリント配線板技術展
	ディジインターナショナル	5E-36	Smart Sensing
	DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン	5F-09	プリント配線板技術展
	TEGソリューション	3B-17	eX-tech
	テクノアルファ	4C-18	JISSO PROTEC
	テスプロ	4D-24	プリント配線板技術展
	TAESUNG	4C-09	プリント配線板技術展
	科惠（澳門）線路	6G-32	プリント配線板技術展
	Tebiki	5E-01	プリント配線板技術展
	デルタツーリング	5E-62-11	Smart Sensing
	デンカ	5F-53	プリント配線板技術展
	電気印刷研究所	3B-04	eX-tech
	電子回路企業年金基金	3A-02	プリント配線板技術展
	電子技研	3B-18	eX-tech
	天津普林電路	6G-23	プリント配線板技術展
	電波新聞社	3A-07	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
と	東亜無線電機	4D-37	Electronics Component & Unit Show
	東海神栄電子工業	6G-30	プリント配線板技術展
	東海理化電機製作所	5E-16	Smart Sensing
	東京エレクトロンデバイス	5E-36	Smart Sensing
	東京工芸大学	3B-57	アカデミックプラザ
	東京都電機卸商業協同組合（TEP）	4D-42	Electronics Component & Unit Show
	東京マシン・アンド・ツール	6H-47	プリント配線板技術展
	東京理科大学	3B-60	アカデミックプラザ
	東京理科大学	3B-61	アカデミックプラザ
	東芝情報システム	5E-40	機器・半導体受託生産システム展
	東芝ビジネスエキスパート	3B-34	eX-tech
	東富士電機	4C-11	WIRE Japan Show
	東北大学	3B-71	アカデミックプラザ
	東北大学　学際科学フロンティア研究所　島津研究室	5E-59	Smart Sensing
	東洋アルミニウム	6H-07	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	東洋リビング	4C-21	JISSO PROTEC
	恵州東和数碼科技 東和デジテック	6G-06	プリント配線板技術展
	東和プリント工業	6G-06	プリント配線板技術展
	トープロテクノサービス	3B-11	eX-tech
	徳島大学	3B-53	アカデミックプラザ
	TOPPAN	3A-28	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	TOPPAN	5E-62-5	Smart Sensing
	TOPPAN エンジニアリング事業	5E-27	機器・半導体受託生産システム展
	トト	6G-25	プリント配線板技術展
	Trojan (Suzhou) Material Technology	5E-15	プリント配線板技術展
	東莞市宝瑞電子	4C-06	WIRE Japan Show
な	内藤電誠工業	6H-14	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	内藤電誠町田製作所	5E-22	Smart Sensing
	中島化学産業	5F-42	プリント配線板技術展
	長瀬産業	6H-13	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	長瀬産業	3B-22	eX-tech
	国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室	3B-51	アカデミックプラザ
	ナラサキ産業	6H-22	プリント配線板技術展
	ナルコーム	5E-21	Smart Sensing
	南陽	5E-62-9	Smart Sensing
に	日理工業	5E-41	機器・半導体受託生産システム展
	ニチワ工業	5E-08	【ゾーン】パワー半導体／ガラス基板向け材料・プロセス技術
	ニッカン工業	5F-37	プリント配線板技術展
	日刊工業新聞社	3A-13	プリント配線板技術展
	ニッコー・マテリアルズ	5F-24	プリント配線板技術展
	日東電工	5E-62-16	Smart Sensing
	日東紡績	5F-50	プリント配線板技術展
	日邦産業	3B-21	eX-tech
	日放電子	6H-12	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	日本ゼオン	6G-33	プリント配線板技術展
	日本電気硝子	6H-01	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	日本トムソン	4C-29	JISSO PROTEC
	ニデックアドバンステクノロジー	4D-17	プリント配線板技術展
	日本アグファマテリアルズ	5F-18	プリント配線板技術展
	日本エバレット・チャールス	4D-19	プリント配線板技術展
	日本MID協会	3B-40	3D-MIDパビリオン
	日本化学工業	5F-11	プリント配線板技術展
	日本サーキット	4D-01	プリント配線板技術展
	日本スペリア社	4C-02	JISSO PROTEC
	日本製鋼所	6H-40	プリント配線板技術展
	日本大学 内木場・金子研究室	3B-58	アカデミックプラザ
	日本大学理工学部精密機械工学科	3B-59	アカデミックプラザ
	日本電子回路工業会（JPCA）書籍販売コーナー	3A-22	プリント配線板技術展
	日本パーンズ	6H-06	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	日本マーテック	5E-26	機器・半導体受託生産システム展
	日本ミルテック	4C-48	JISSO PROTEC
	日本レーザー	5E-10	プリント配線板技術展
	日本ロボット工業会（JARA）	4C-34	JISSO PROTEC
の	ノードソン	3B-31	eX-tech
	ノマ電気	4D-31	Electronics Component & Unit Show
は	パーミジャパン	4C-49	JISSO PROTEC
	ハイウィン	4C-20	JISSO PROTEC
	伯東	5F-55	プリント配線板技術展
	パスコン	4C-27	JISSO PROTEC
	白光	4C-47	JISSO PROTEC
	八光電子工業	4D-09	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	パナソニック コネクト	4D-45	JISSO PROTEC
	ハニー化成	3B-07	eX-tech
	Hanel Production And Import-Export Joint Stock Company	5E-11	機器・半導体受託生産システム展
ひ	ピアメカニクス	6H-47	プリント配線板技術展
	PCBGOGO	5F-19	プリント配線板技術展
	ビーム	6G-18	プリント配線板技術展
	日川電機	4D-35	Electronics Component & Unit Show
	ビザスク	6H-16	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	日立ハイテクサイエンス	6G-17	プリント配線板技術展
	平山ファインテクノ	5F-22	プリント配線板技術展
ふ	ファインテック	6H-27	プリント配線板技術展
	ブイ・テクノロジー	6G-39	プリント配線板技術展
	フィッシャー・インストルメンツ	5E-14	プリント配線板技術展
	フォアサイト	5E-09	【ゾーン】パワー半導体／ガラス基板向け材料・プロセス技術
	福田金属箔粉工業	5F-41	プリント配線板技術展
	FUJI	5E-63	JISSO PROTEC
	フジ機工	6H-29	プリント配線板技術展
	藤倉コンポジット	5E-62-4	Smart Sensing
	不二越	6G-40	プリント配線板技術展
	富士電子	5E-42	機器・半導体受託生産システム展
	フジトク	5E-28	Smart Sensing
	フジプリグループ	4D-06	プリント配線板技術展
	藤森工業	5F-43	プリント配線板技術展
	Pudu Robotics Japan	3B-39	プリント配線板技術展
	プラズマイオンアシスト	3B-29	eX-tech
	プリント回路ジャーナル	3A-18	プリント配線板技術展
	プリント電子研究所	3A-21	プリント配線板技術展
	ブルックス・ジャパン	4C-41	JISSO PROTEC
	ブルックスジャパン	6G-34	プリント配線板技術展
	プロセス・ラボ・ミクロン	4C-24	JISSO PROTEC
へ	ペアック	6H-28	プリント配線板技術展
	Haesung DS	6H-17	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	PEMTRON	4C-31	JISSO PROTEC
ほ	Huizhou Ronai Technology	4D-04	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	Bocek	5E-46	無人化ソリューション展
	北海道大学	3B-65	アカデミックプラザ
	ホルトプラン	5E-19	Smart Sensing
ま	マイクロクラフト	6H-41	プリント配線板技術展
	マイクロモジュールテクノロジー	5E-61	Smart Sensing
	MAIDA JAPAN／創信日本	5E-02	プリント配線板技術展
	Mouser Electronics	5E-25	Smart Sensing
	マウビック	4C-53	機器・半導体受託生産システム展
	マクセル	5E-24	Smart Sensing
	マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	5F-17	プリント配線板技術展
	マクニカ	5E-62-6	Smart Sensing
	マコー	6G-09	プリント配線板技術展
	マックエイト	6G-27	プリント配線板技術展
	丸源鐵工所	6H-39	プリント配線板技術展
	マルコム	4C-36	JISSO PROTEC
	マルティスープ	5E-62-10	Smart Sensing
	丸文	5E-06	【ゾーン】アドバンスドパッケージング技術
	丸文	5E-18	Smart Sensing
み	ミカドテクノス	6H-31	プリント配線板技術展
	ミクロ技術研究所	5F-33	プリント配線板技術展
	三井化学ICTマテリア	6H-02	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	三井金属鉱業	6H-09	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
	三ツ波	5E-35	Smart Sensing
	三菱ガス化学	5F-38	プリント配線板技術展
	三菱電機	6G-42	プリント配線板技術展
	三ツ星ベルト	3B-24	eX-tech
む	武蔵エンジニアリング	4C-30	JISSO PROTEC
	ムラキ	6H-20	プリント配線板技術展
め	メイコー	6G-13	プリント配線板技術展
	MeiLink	6G-13	プリント配線板技術展
	メック（神奈川）	5E-43	機器・半導体受託生産システム展
	メック（兵庫）	5F-26	プリント配線板技術展
	メトロ電気	4D-36	Electronics Component & Unit Show
も	MODE, Inc.	5E-62-1	Smart Sensing
	モトロニクス	6H-37	プリント配線板技術展
	ものづくりドットコム	5E-17	Smart Sensing
や	ヤシマ電気	5E-03-03	Smart Sensing
	山形県工業技術センター	3B-55	アカデミックプラザ
	山形大学	3B-54	アカデミックプラザ
	山下マテリアル	4D-11	フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
	ヤマハ発動機	5F-54	JISSO PROTEC
	ヤマハモーターエンジニアリング	5E-23	無人化ソリューション展
ゆ	ユアサシステム機器	5E-12	プリント配線板技術展
	ユニオンツール	5F-49	プリント配線板技術展
よ	ヨクスル	3A-09	プリント配線板技術展
	横浜国立大学	3B-73	アカデミックプラザ
	横浜国立大学	3B-72	アカデミックプラザ
	横山商会	5E-03-04	Smart Sensing
ら	ライズエレクトロニクス	6G-32	プリント配線板技術展
り	利昌工業	5F-39	プリント配線板技術展
	リンテック	5E-03-06	Smart Sensing
る	ルックス電子	4C-40	JISSO PROTEC
れ	レイマック	5E-49	Smart Sensing
	レヨーン工業	6H-44	プリント配線板技術展
ろ	ローデ・シュワルツ・ジャパン	4D-27	プリント配線板技術展
	ロボサピエンス	5E-56	Smart Sensing
	ロボティック普及促進センター	5E-51	無人化ソリューション展
わ	YMT	5F-28	プリント配線板技術展
	ワンダーフューチャーコーポレーション	3B-41	3D-MIDパビリオン

カンファレンスマップ

JPCA Show 2024 第53回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第38回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2024 第25回 実装プロセステクノロジー展 / METAVERSE DEVICE EXPO メタバースデバイス展 / WIRE Japan Show 2024 ～装置と装置をつなぐ～ 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show JEF 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 / E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング

展示ホール内セミナー会場案内図



電子機器トータルソリューション展　基調講演　有料　VIP/会員無料　要事前登録　セミナー会場A

聴講料：会員・VIP 無料、非会員 20,000円／1セッション（聴講料は税込です） ※JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員・学生会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP会員

	6月12日（水）	6月13日（木）	6月14日（金）
10:30～11:20	AIチップインパクトで半導体、実装基板は一大飛躍の時代を迎えた！～北海道から九州まで「シリコン列島ニッポン」ともいうべき巨大設備投資～ **泉谷 渉** ㈱産業タイムズ社　代表取締役会長	スピントロニクス省電力半導体～高度情報化社会と低炭素社会への貢献～ **遠藤 哲郎** 東北大学　国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長／教授　東北大学　工学研究科　教授	加速する未来への挑戦：Rapidusの半導体後工程戦略 **折井 靖光** Rapidus㈱　3Dアセンブリ本部 専務執行役員・3Dアセンブリ本部長
11:30～12:20	村田製作所の開発動向と車載向けデバイスの展開 **岩坪 浩** ㈱村田製作所　技術・事業開発本部　取締役 専務執行役員	次世代コンピューティング向けアドバンスト ヘテロジニアスインテグレーションプラットフォーム "ムーアの法則を超えて" **苅谷 隆** 日本サムスン㈱　Samsung デバイスソリューションズ研究所 Advanced Package Lab. Corporate Vice President / Lab長	Aiとロボットが融合する未来～次世代ロボットビジョン～ **尾形 哲也** 早稲田大学　AIロボット研究所　所長
12:30～13:20			SDV（Software Defined Vehicle）に求められる車載電子システムとは **三田村 健** 日立Astemo㈱　電動ビジネス事業部 SDV プラットフォーム統括本部　SVP、統括本部長

JIEP 最先端実装技術シンポジウム　有料　要事前登録　最先端実装技術シンポジウム　A会場・B会場

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要です（VIP登録された場合も有料です）。会員区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。**www.jpcashow.com/show2024/**
「※」マークがついている講演資料は講演データ（有料）に含まれません。

日	Time	A会場	B会場
6月12日（水）	Title	**12A-1** 10:15-12:45 グリーンデバイスの未来戦略　座長：土門 孝彰、西田 秀行	**12B-1** 10:15-12:45 5G/6G向け高周波対応材料開発動向　座長：松本 博文、高野 希
	10:15-11:05	**12A1-1** 大口径ダイヤモンド基板のヘテロエピタキシャル成長とデバイス応用※ **金 聖祐**　Orbray㈱　Orbrayダイヤモンド研究所　所長	**12B1-1** 5G/6G に向けた低伝送損失基板材料の技術開発動向 **日高 圭芸**　㈱レゾナック　エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部　チームリーダー
	11:05-11:55	**12A1-2** 究極の半導体デバイス！　ダイヤモンドパワー半導体の現状と課題 **嘉数 誠**　佐賀大学　理工学部理工学科電気電子工学部門　教授	**12B1-2** 5G/6Gを見据えた高速高周波用プリント基板用材料の開発動向 **森野 正行**　AGC㈱　化学品カンパニー　機能化学品事業本部　応用商品開発部 用途開発グループ　グループリーダー
	11:55-12:45	**12A1-3** 世の中に最大限貢献できるGaNデバイスとその取組みの紹介※ **山口 雄平**　ローム㈱　LSI事業本部 パワーステージ商品開発部　統括課長	**12B1-3** 高周波プリント配線板、サブストレートを支える低誘電材料、平滑導体との高信頼性接合技術 **八甫谷 明彦**　㈱ダイセル　スマートSBU　グループリーダー
	Title	**12A-2** 13:30-16:00 パワーモジュールの最新技術と今後の展開　座長：渡邉裕彦、和嶋元世	**12B-2** 13:30-16:00 光電融合技術の新潮流と最新動向　座長：谷 元昭、中條 徳男
	13:30-14:20	**12A2-1** SiC/GaNパワーデバイスの最新動向 **岩室 憲幸**　筑波大学　数理物質系　教授	**12B2-1** AIクラウドデータセンタ応用光インタコネクトの最新動向 **高井 厚志**　LitAhead　Independent Consultant
	14:20-15:10	**12A2-2** パワーデバイス向け電子部品の課題と動向 **梶田 栄**　NPO法人サーキットネットワーク　理事長	**12B2-2** Co-Packaged Opticsに向けた実装技術 **那須 秀行**　古河電気工業㈱　フォトニクス研究所光電融合技術開発部　部長／主幹研究員
	15:10-16:00	**12A2-3** パワーモジュールの最新技術と今後の展開「車載用パワー半導体モジュールのパッケージ技術」※ **両角 朗**　富士電機㈱　半導体事業本部 開発統括部　パッケージ開発部　要素技術一課　主査	**12B2-3** PCI express光伝送の動向とそれを実現する光電集積モジュール **赤星 知幸**　京セラ㈱　先進マテリアルデバイス研究所
6月13日（木）	Title	**13A-1** 10:15-12:45 自動運転に向けた車載機器の動向と実装技術　座長：三宅 敏広、齊藤 雅之	**13B-1** 10:15-12:45 GenerativeAI（Chat GPT等と半導体の先端技術（ガラス基板動向含む）　座長：土門 孝彰、西田 秀行
	10:15-11:05	**13A1-1** 自動運転シャトルのしくみと開発動向※ **中嶋 太郎**　㈱マクニカ　スマートシティ＆モビリティ事業部スマートモビリティ事業推進部 第2課　リーダー	**13B1-1** 2024年から始まる異次元の半導体成長シナリオ **南川 明**　インフォーマインテリジェンス（同）　コンサルティング　シニアコンサルティングディレクター
	11:05-11:55	**13A1-2** 手のひらサイズの長距離LiDARと点群処理ミドルウェア **崔 昭秀**　㈱東芝　NEXTビジネス開発部　新規事業推進室	**13B1-2** 生成AIにおける半導体パッケージングの標準化について **吉田 浩芳**　大阪大学　フレキシブル3D実装協働研究所　特任研究員／IEC SC47D国際幹事
	11:55-12:45	**13A1-3** 車載プリント配線板の高密度、高放熱、高速伝送に向けた基板開発の取り組み **戸田 光昭**　㈱メイコー　技術マーケティング企画室　室長	**13B1-3** 生成AI用先端半導体パッケージングの技術動向※ **宇都宮 久修**　インターコネクション・テクノロジーズ㈱　代表取締役
	Title	**13A-2** 13:30-16:00 EV車載機器の動向と実装技術　座長：三宅 敏広、池田 浩昭	**13B-2** 13:30-16:00 メタバース時代のデバイス・半導体PKG実装技術動向　座長：土門 孝彰、西田 秀行
	13:30-14:20	**13A2-1** 経済安全保障の車載電池を巡るグローバル競争と日本の課題 **佐藤 登**　名古屋大学　未来社会創造機構　客員教授／エスペック㈱　役員室　上席顧問／イリソ電子工業㈱　役員室　社外取締役	**13B2-1** XRが牽引するマイクロディスプレー動向※ **澤登 美英子**　㈱産業タイムズ社　編集部　主任
	14:20-15:10	**13A2-2** 車載電気機器における材料と実装技術の高度融合技術の紹介と次世代自動車に求められるパワー半導体実装技術～熱マネジメントの視点から・日産アリアやテスラの事例を含めて～ **山本 真義**　名古屋大学　未来材料・システム研究所　教授	**13B2-2** 先端プロセッサーとPKG市場の動向 **山本 義継**　みずほ証券　エクイティ調査部　シニアアナリスト
	15:10-16:00	**13A2-3** インバータの小型・高性能化に貢献する三菱電機の自動車用パワーモジュール **飯塚 新**　三菱電機㈱　パワーデバイス製作所パワーデバイス第一部 自動車製品設計第二課	**13B2-3** 生成AIモデルサイズ拡大に対応するチップレットパッケージの挑戦課題 **西尾 俊彦**　㈱SBRテクノロジー　代表取締役
6月14日（金）	Title	**14A-1** 10:15-12:45 半導体の最新動向、次世代半導体とは?　座長：土門 孝彰、西田 秀行	**14B-1** 10:15-12:45 高密度・高機能化を支える先端配線板技術　座長：谷 元昭、佐藤 牧子
	10:15-11:05	**14A1-1** 半導体製造装置の市場動向 **渡部 潔**　（一社）日本半導体製造装置協会　専務理事	**14B1-1** ガラス基板の開発動向とフォトニクス分野への応用 **酒井 泰治**　FICT㈱　テクノロジ本部先行技術開発部　プロジェクト部長
	11:05-11:55	**14A1-2** 半導体業界の明るい展望※ **和田木 哲哉**　モルガン・スタンレーMUFG証券㈱　調査統括本部　マネージング ディレクター	**14B1-2** Weak-Micro Viaを解決する高接続信頼性の無電解銅めっき技術 **北原 悠平**　奥野製薬工業㈱　総合技術研究部 第三研究室　室長
	11:55-12:45	**14A1-3** 半導体技術の新たな転換点ー2nm世代半導体デバイス・プロセス技術※ **小林 正治**　Rapidus　シリコン技術本部　デバイス技術部ディレクター／東京大学　d.lab　准教授	**14B1-3** 次世代BTレジン積層材料の技術開発動向 **伊藤 環**　三菱ガス化学㈱　機能化学品事業部門企画開発部電子材料グループ　主査
	Title	**14A-2** 13:30-16:00 チップレット集積の現状と課題　座長：西田 秀行、齊藤 雅之	**14B-2** 13:35-16:20 半導体微細加工／新構造導電ペーストでウェアラブルデバイスが変わる　座長：本多 進、猪川 幸司
	13:30-14:20	**14A2-1** チップレット集積技術の最新動向 **栗田 洋一郎**　東京工業大学　産業科学技術創成研究院　特任教授	**14B2-1** FOWLPと三次元実装技術で創る iFHE（インモールド・フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス） **福島 誉史**　東北大学　大学院工学研究科・機械機能創成専攻　准教授
	14:20-15:10	**14A2-2** TSMCの3DIC技術と日本のエコシステムの融合で世界のイノベーションを生み出す※ **安原 隆太郎**　TSMCジャパン　3DIC研究開発センター㈱　プロセスインタラクション部門　プリンシパルエンジニア	**14B2-2** MEMS製造の最新技術とウェアラブルデバイスへの応用 **金尾 寛人**　SPPテクノロジーズ㈱　製造部兼生産管理兼マーケッティング　次長
	15:10-16:00	**14A2-3** ウェーハ・トゥ・ウェーハ, ダイ・トゥ・ウェーハ・ハイブリッド接合による集積技術※ **山本 宏**　イーヴィグループジャパン㈱　代表取締役	**14B2-3** ウェアラブルデバイス応用に向けたフレキシブル・ストレッチャブル配線材料の開発状況 **井上 雅博**　群馬大学大学院理工学府　知能機械創製部門　准教授

JIEPアカデミックプラザ　無料　事前登録不要　セミナー会場E

	6月12日（水）	6月13日（木）	6月14日（金）
13:00-13:20	脳波計用皮膚等価ファントムの試作と測定環境が脳波測定におよぼすノイズの違いの調査　東京理科大学創域理工学部電気電子情報工学科	金属塩生成接合法による電子実装材料の低温精密固相接合　群馬大学大学院 理工学府	グラフニューラルネットワーク（GNN）を用いた電気回路間の類似領域抽出手法　大阪電気通信大学大学院
13:20-13:40	誘電型加温を用いた低温調理における一般生菌の殺菌効果　東京理科大学創域理工学部電気電子情報工学科	銀系導電性接着剤のミクロフィラーの低温焼結と金属電極に対する接着界面特性の制御のための樹脂バインダ配合設計　群馬大学大学院理工学府	深層強化学習を用いたフライングプローブテスタによる基板検査の高速化　愛媛大学
13:40-14:00	ワイヤレス電力伝送を実装した実験小動物用光刺激装置の試作と動物実験による性能評価　東京理科大学	銅系導電性ペーストの酸化許容設計による電気的信頼性の向上　群馬大学大学院 理工学府	待機状態IC の入力記線検査を行うバウンダリスキャン用コントローラの試作　徳島大学大学院創成科学研究科
14:00-14:20	広帯域化と低群遅延特性の両立を目指した GHz帯薄膜コモンモードフィルタの開発　信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス（佐藤・曽根原）研究室	ハイブリッド接合における接合強度と界面評価　横浜国立大学	ロータス波状フィンの空冷性能向上のメカニズム解明に向けたフィン間通過流の可視化および高速品質保証技術の提案　山口東京理科大学
14:20-14:40	畜産分野や動物園におけるセンサシステムの実証　崇城大学	低温焼成による高強度接合を可能とする銅粒子系　北海道大学 大学院工学研究院 米澤研究室	聴覚障害者のための深層学習を用いた警告音通知システムの開発　長野工業高等専門学校
15:00-15:20	リングを配置するメタマテリアルを利用した低姿勢広帯域円偏波パッチアンテナ　東京工芸大学大学院 工学研究科	深共晶溶媒を用いたアルミニウム電析への第四級アンモニウム塩微量添加効果　関東学院大学大学院工学研究科小岩研究室	歩容の切り替えと障害物をまたぎ越し可能な2足歩行制御用ニューラル回路網モデルの開発　日本大学 / マイクロデザイン研究室
15:20-15:40	ITO透明導電膜を利用したコプレーナ線路の伝送特性の検討　東京工芸大学	紫外線照射で選択析出した無電解ニッケル-リン薄膜上への無電解銅めっきの選択析出　関東学院大学大学院工学研究科	MEMSマイクロロボットの実用化に向けた歩行の動力学解析　日本大学 マイクロデザイン研究室
15:40-16:00	グラウンド部を積層階段状化させたパッチアンテナの放射特性広角化の検討　東京工芸大学大学院 工学研究科	ポリシラザンのシリカ転化反応を利用した常温ウェハ接合技術　東北大学	圧搾ガス駆動による内視鏡接続型MEMSマイクロロボットの開発　日本大学 マイクロデザイン研究室
16:00-16:20	スパイラルコイルを利用した経皮的情報伝送におけるコイルの位置ずれに対する磁界分布の検討　東京工芸大学大学院	プリント基板レーザ穴加工の加工穴パラメータ予測におけるスタッキングアンサンブル学習の応用　同志社大学理工学研究科機械専攻生産システムデザイン研究室	電子機器の温度上昇を抑制する超小型MEMSベーパーチャンバーの開発　日本大学 マイクロデザイン研究室
16:20-16:40		超硬ドリルカタログにおけるデータマイニングによるプリント基板ドリル加工条件の設定支援システム構築と解析　同志社大学大学院生	MEMSマイクロロボットへ実装する回転型静電モータの開発　日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻
16:40-17:00		B5G/6Gパッケージ基板基板向けプラズマ表面改質による難接着材料の直接接合　電子技研	

JISSO PROTEC 特別講演　無料　要事前登録　セミナー会場G

	6月12日（水）	6月13日（木）	6月14日（金）
10:30～11:20	モバイル機器の最新業界動向と見通し **中根 康夫** みずほ証券㈱　エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト	2030年の電動車の未来像と そこに必要とされるパワー半導体応用システム における実装技術要求と将来動向 **山本 真義** 名古屋大学　未来材料・システム研究所　教授	2024年度版 JEITA実装技術ロードマップの紹介～実装設備の最新動向～ **前田 憲** JEITA実装技術ロードマップ専門員会 実装設備WG（WG6）主査／パナソニック コネクト㈱　プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス開発総括部　印刷技術開発部 主幹技師

PROTECセミナー　無料　要事前登録　セミナー会場H

日	時間	講演	講演者
6月12日（水）	11:45-12:30	大型の基板・実装部品に対応したディスペンス技術のご紹介	**新井 武**　武蔵エンジニアリング㈱　マーケティング戦略本部　係長
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2024	**若林 利昌**　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT営業部　SPグループ
	14:05-14:50	生産現場の改善／改革と印刷技術にFUJIの印刷機が貢献できること	**櫻山 岳史**　㈱FUJI　ロボットソリューション事業本部　PMプロジェクト　プロジェクトリーダー
	15:15-16:00	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化～Auto Setting Feeder～	**礒端 美伯**　パナソニックコネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　フロア自動化開発部　部長
6月13日（木）	11:45-12:30	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化～Auto Setting Feeder～	**礒端 美伯**　パナソニックコネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　フロア自動化開発部　部長
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2024	**若林 利昌**　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT営業部　SPグループ
	14:05-14:50	スマートファクトリーの最前線　部品管理から後工程まで一気通貫のソリューションをご提案	**松浦 東吾**　JUKIオートメーションシステムズ㈱　開発センター　実装機器開発部　第2設計グループ
	15:15-16:00	生産現場の改善／改革と電子部品実装技術にFUJIの実装機が貢献できること	**山蔭 勇介**　㈱FUJI　ロボットソリューション事業本部　NXTRプロジェクト　プロジェクトリーダー
6月14日（金）	11:45-12:30	生産現場の改善／改革と止まらない電子部品実装ラインにFUJIの「自動化」ができること	**森田 幸寿**　㈱FUJI　ロボットソリューション事業本部　スマートファクトリー開発部　課長
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2024	**若林 利昌**　ヤマハ発動機㈱　ロボティクス事業部　営業統括部　SMT営業部　SPグループ
	14:05-14:50	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化～Auto Setting Feeder～	**礒端 美伯**　パナソニックコネクト㈱　プロセスオートメーション事業部　回路形成プロセス事業担当　回路形成プロセス開発総括部　フロア自動化開発部　部長
	15:15-16:00	仮題：カーボンニュートラルに貢献する低温実装技術	千住金属工業㈱

ダントツものづくりセミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場C

6月12日（水）生産性向上ものづくり特別セッション		6月13日（木）グローバルサプライチェーンと品質管理セッション		6月14日（金）TOC / 管理会計セッション	
13:00～13:45	**0612TK** 【特別基調講演】生産性向上の時代における地域スクール/JPCAものづくりアカデミーの役割 **藤本 隆宏** 東京大学名誉教授／早稲田大学教授	13:00～14:00	**0613T3** 【特別講演3】強靭なものづくりサプライチェーンの構築 **新宅 純二郎** 東京大学名誉教授／明治大学教授	13:00～13:45	**0614T4** 【特別講演4】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション **岸良 裕司** ゴールドラット・ジャパン　CEO
13:45～14:30	**0612TK** 【特別基調講演】賃金上昇、人手不足、原材料高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上しかない！ **藤本 隆宏** 東京大学名誉教授／早稲田大学教授	14:05～15:05	**0613S1** JPCAものづくり大賞／準大賞受賞（2022年度）改善取組み事例報告3件 大賞受賞 FICT㈱長野本社製造本部 車載向け基板の少人化検査ラインの構築 準大賞受賞 ㈱メイコー福島工場 外周仕上げライン生産性改善 準大賞受賞 太陽インキ製造㈱埼玉工場 埼玉工場の作業の標準化	13:45～14:30	**0614T5** 【特別講演5】月曜日が楽しみな会社にしよう！～全体最適のマネジメント理論TOCとは～ **岸良 裕司** ゴールドラット・ジャパン　CEO
14:35～15:20	**0612T1** 【特別講演1】トヨタ式現場管理 **田中 正知** トヨタ自動車OB（ものづくり大学名誉教授/J-J-コスト研究所代表）			14:35～15:20	**0614T6** 【特別講演6】電子回路ものづくり企業の『現場改善』について『お金の良い流れ』から考える **柊 紫乃** 愛知工業大学　経営学部経営学科　教授
15:20～16:05	**0612T2** 【特別講演2】現場改善のJコスト理論による強化策（ROA） **田中 正知** トヨタ自動車OB（ものづくり大学名誉教授/J-J-コスト研究所代表）	15:10～15:50	**0613K1** 【基調講演】経営効果がわかる、トヨタ生産システム「業界の生産性向上実績」 **山本 治彦** JPCAものづくりアカデミー校長／E-ESMAP研究会特別顧問	15:20～16:05	**0614T7** 【特別講演7】経営者は何を管理すれば現場改善効果を見える化できるのか『現場改善会計（GKC）』 **柊 紫乃** 愛知工業大学　経営学部経営学科　教授

Smart Sensing/無人化ソリューション展 Innovation Summit Edge Computingセミナー　無料　要事前登録　セミナー会場F

Keynote Speech

6月12日（水）	
10:15-11:05	Pudu Roboticsからの省力化ソリューションご提案 **張濤**　Pudu Robotics　CEO
11:35-12:25	変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を～チップレット及びセンサー最新市場動向と開発事例～ **平田 勝則**　コネクテックジャパン㈱　代表取締役　会長

6月13日（木）	
10:15-11:05	インターバース技術によるバーチャルエコノミーの拡大 **持丸 正明**　（国研）産業技術総合研究所　人間拡張研究センター フェロー 兼 研究センター長
11:35-12:25	振動発電『V-GENERATOR』のサプライチェーンについて **北 翔太**　金沢大学　先端科学・社会共創推進機構　特任助教 **泉 聖志**　住友金属鉱山㈱ **峰 佳祐**　㈱横山商会 **櫻井 広樹**　ヤシマ電気㈱
13:45-14:35	理想をカタチにするテクノロジー ～AIと融合する最先端デバイスの紹介 **廣田 大輔**　ウルト・エレクトロニクス・ジャパン㈱ FAE・フィールドアプリケーション エンジニア **森野 航一**　日清紡マイクロデバイス㈱　営業本部　営業統括部　FAE課 専門課長 **柴田 尚久**　日本ケミコン㈱　ソリューション開発部　専門マネージャ **西川 裕**　トレックス・セミコンダクター㈱　マーケティング部 グローバルマーケティンググループ　リーダー

6月14日（金）	
11:35-12:25	生成AIで激変するセンサーの価値 **上野 聡志**　MODE, Inc.　Vice President of Business

パネルディスカッション

6月14日（金）	
10:15-11:05	においセンサの未来展望 ～においセンサで社会は変わる～ モデレーター **吉川 元起**　国立研究開発法人物質・材料研究機構　機能性材料研究拠点 グループリーダー パネリスト **今村 岳**　㈱Qception　代表取締役 **喜多 純一**　㈱におい科学研究所　代表 **黒木 俊一郎**　㈱アロマビット　代表取締役兼CEO

企業プレゼンテーション

6月12日（水）	
13:45-14:25	多品種変量時代にはビジネスモデルで戦う"半導体後工程に付加価値チャンスあり" **安藤 守**　コネクテックジャパン㈱　取締役　常務執行役員
14:45-15:25	極限環境分野においていかに収益化を目指すか（ハイブリッドデュアルユース/ダブルインカム）民生技術の発掘・育成（安全保障技術研究推進制度と先進技術の橋渡し研究） **小林 賢一**　NPO法人ロボティック普及促進センター　理事長／㈱ロボットメディア　代表取締役 **南 亜樹**　防衛装備庁　技術戦略部　技術連携推進官

6月13日（木）	
12:45-13:25	センシングアプリケーション用赤外線LED（IR LEDs for Sensing Applications） **Murali Kumar**　Luminus Devices（presented by 丸文） Non-Visible Products Business Line Director

6月14日（金）	
12:45-13:25	DX推進を担うセンサー技術活用について～プロセス改善、自動化、省人化の礎～ **鈴木 崇司**　ものづくりドットコム　エキスパート会員 神上コーポレーション㈱
13:45-14:25	センシング向けIoT無線通信デバイスの紹介～セルラー/LPWA/ザブギガ/2.4GHz XBee + Digi Remote Managerで遠隔管理～ **江川 将峰**　ディジインターナショナル㈱　代表取締役社長

Electronics Component & Unit Show 出展者プレゼンテーション　無料　事前登録不要　セミナー会場F

6月13日（木）		
15:00-15:30	「気付きでDXを活気付き！」～まずは「みる」ことから始めませんか～	東亜無線電機㈱

出展者（NPI）プレゼンテーション　無料　事前登録不要　セミナー会場D

日	時間	講演	出展者
6月12日（水）	10:30-10:50	自前でのPCB基板作製、フレキシブル・エレクトロニクスのプロトタイプの基板試作 電子回路プリンタ V-ONE / NOVA	テクノアルファ㈱
	11:05-11:25	3D-MID/PEの社会実装と電子基板分野での脱炭素をIHリフロー目線でトータルサポート	㈱ワンダーフューチャーコーポレーション
	11:40-12:00	高温度環境下での使用を想定した小型・大容量固体二次電池の開発	三桜工業㈱
	12:15-12:35	Wafer/Panel-Level Packagingのガラス微細加工技術　LPKF LIDE®のご紹介	LPKF Laser & Electronics㈱
	12:50-13:10	部品実装データ支援システム「PC-MountCAM」を中心とするダイナトロン実装ソリューションのご紹介	ダイナトロン㈱
	13:25-13:45	LE-TECHNOLOGYの最先端ダイレクト露光装置のご紹介	㈱ブイ・テクノロジー
	14:00-14:20	AIを活用してLSI評価業務の効率を上げる！　波形特性自動判定ソフト「Waveform Meister」の活用法	東芝情報システム㈱
	14:35-14:55	LTspice 新versionについて	㈱三共社
	15:10-15:30	LTspice 新versionについて	㈱三共社
	15:45-16:05	Hanel PTのご紹介	HANEL 生産・加工委託及び輸出入㈱
	16:20-16:40	グリーンテクノロジー - IC基板製造の生産性と持続可能性を実現	イー・エス・アイ・ジャパン㈱
6月13日（木）	10:30-10:50	シャドープラス	マクダーミッドアルファ
	11:05-11:25	高密度貫通スルーホールコア基板向け硫酸銅めっき浴	上村工業㈱
	11:40-12:00	シブヤのレーザアブレーション加工機とFPC、PCB加工例の紹介	澁谷工業㈱
	12:15-12:35	超・低消費動作を実現！　Bluetooth仮想メッシュネットワークのご紹介	㈱内藤電誠町田製作所
	12:50-13:10	基板分割はレーザーカットの時代へ - LPKFレーザーデパネリングテクノロジーセミナー	LPKF Laser & Electronics㈱
	13:25-13:45	基板製造・基板実装の異物不良ソリューション ～100µm未満の微小異物を確実且つ安全にクリーニングするための基礎知識～	㈱ブルックスジャパン
	14:00-14:20	反射電子とX線を同時検出する革新的な検出器「Unity」を使用した、電子部品の高速・高精細元素マップ解析事例	オックスフォード・インストゥルメンツ㈱
	14:35-14:55	SCREENのPKG基板向け最新露光装置（Lediaシリーズ）の技術紹介	㈱SCREEN PEソリューションズ
	15:10-15:30	デバイス実装材料の特性を見える化する！　熱分析・粘弾性+αの複合分析	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱
	15:45-16:05	SMTリフローに対するドイツ・IBL社の新たな取り組み インラインVPSリフロー装置・CCS100のご紹介	テクノアルファ㈱
	16:20-16:40	高密度先端PKGが実現！ Φ3umの超微細ビア加工を可能とするエキシマレーザー加工装置Exa-Ms5&進化を遂げた究極のダイレクト露光装置GDi-MPv2の紹介	㈱オーク製作所
6月14日（金）	10:30-10:50	パワーデバイス向けリードフレーム用　粒状銅めっき添加剤「トップクラスターAR」	奥野製薬工業㈱
	11:05-11:25	Vテクノロジーの製造業向けITソリューション	㈱ブイ・テクノロジー
	11:40-12:00	大型の基板・実装部品に対応したディスペンス技術のご紹介	武蔵エンジニアリング㈱
	12:15-12:35	電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報	ユニオンツール㈱
	12:50-13:10	3D-MID/PEの社会実装と電子基板分野での脱炭素をIHリフロー目線でトータルサポート	㈱ワンダーフューチャーコーポレーション
	13:25-13:45	経時変化が無い!?マイルドプラズマ技術による表面改質効果とその応用について	エステック㈱
	14:00-14:20	熱設計のフロントローディングに役立つ熱シミュレーションツールの効果的な使い方	㈱IDAJ
	14:35-14:55	オンテックが自社開発したAI自動配置ツールのライブデモンストレーション！！	㈱オンテック
	15:10-15:30	新時代のプリント基板搬送：軽量・汎用・ワンハンドで作業効率を劇的に向上！	シュマルツ㈱
	15:45-16:05	パラジウム触媒付きアルミ箔が促す超微細かつ高周波対応のパッケージ基板へのイノベーション（A-SAP Technology）	東洋アルミニウム㈱
	16:20-16:40	ヘテロジニアスインテグレーション向け再配線層内蔵コアレス基板（有機インターポーザー）のご紹介	TOPPAN㈱

主催者セミナー（出展者講演枠）　無料　事前登録不要　セミナー会場C

6月12日（水）	
10:30-11:15	最先端PKGサブストレートに対応し、更に環境に配慮しためっきプロセス・設備のご紹介 **ドン・ジャン**　アトテックジャパン㈱

6月14日（金）	
10:30-11:15	製造業における試作／量産／評価データを有効活用する DX戦略の１つとしてのプロセスインフォマティクス活用 **高石 将輝**　アイクリスタル㈱

3D-MIDパビリオンセミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場E

6月12日（水）	
10:15-10:45	MID の概要と、日本MID 協会の活動紹介 **浅見 朗子**　日本MID協会　幹事
11:00-11:30	無粗化・高密着パターンめっきプロセスによる高周波対応3D-MID **目黒 和幸**　（地独）岩手県工業技術センター　電子情報システム部　上席専門研究員
11:45-12:15	3D-MID＆次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介 **松澤 浩彦**　㈱図研　技術本部EL開発部　シニア・パートナー

6月13日（木）	
10:15-10:45	MID の概要と、日本MID 協会の活動紹介 **松澤 浩彦**　日本MID協会　幹事
11:00-11:30	高耐熱バイオマス材料MIDへの取り組み **吉澤 徳夫**　三共化成㈱　東京本社　技術本部
11:45-12:15	JEITA 実装用MIDテクニカルレポートPG活動紹介 The Value and Considerations of MID through Additive Manufacturing **坂本 一三**　電子情報技術産業協会（JEITA）電子実装技術標準化専門委員会　主査

6月14日（金）	
10:15-10:45	MID の概要と、日本MID 協会の活動紹介 **遊佐 敦**　日本MID協会　幹事
11:00-11:30	高耐熱バイオマス材料MIDへの取り組み **小田 雅也**　三共化成㈱　東京本社　技術本部
11:45-12:15	私たちの3D-MIDへの挑戦 **岡庭 年春**　㈱ワンダーフューチャーコーポレーション　営業部　取締役営業部長

ぷりんとばんじゅくセミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場B

6月12日（水）	
13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎"ぷりんとばんじゅくⅠ"をもとに解説 **榧場 正男**　㈱カヤバオフィス　代表取締役
14:15-15:15	プリント配線板設計の基礎"ぷりんとばんじゅくⅡ"をもとに解説 **田中 弘文**
15:30-16:30	フレキシブル配線板の基礎"ぷりんとばんじゅくⅦ"をもとに解説 **宮﨑 博明**

6月14日（金）	
12:30-13:30	実装の基礎"ぷりんとばんじゅくⅤ"をもとに解説 **榧場 正男**　㈱カヤバオフィス　代表取締役
13:45-14:45	品質管理の基礎 **安井 博文**　安井事務所　PWBコンサルタント

製品化学物質管理セミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場B

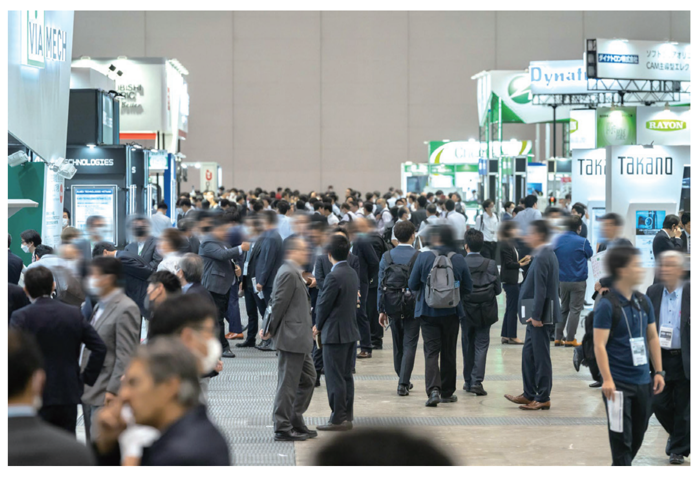
6月13日（木）	
15:00-16:15	PFAS規制化の動向と電子機器業界の対応 **菅原 高嶺**　日本フルオロケミカルプロダクト協議会　AGC㈱　化学品カンパニー

製品安全セミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場B

6月13日（木）	
13:30-14:30	プリント配線板のUL796評価と背景を解説 **榧場 正男**　㈱カヤバオフィス　代表取締役

JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー　無料　事前登録不要　セミナー会場I

6月12日（水）	
13:30-14:30	プリント配線板技術ロードマップ解説とガラス・サブストレート技術トレンド **宇都宮 久修**　インターコネクション・テクノロジーズ㈱　代表取締役

PWBコンサルタントスキルアップセミナー　無料　要事前登録　セミナー会場I

対象　PWBコンサルタント、PWBインストラクタ1級・準1級資格保有者の方のみ
6月14日（金）15:00～16:45